

公司代码：600460

公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,664,071,845 股，以此计算合计拟派发现金红利 133,125,747.60 元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	士兰微	600460	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈越	陆可蔚
联系地址	浙江省杭州市黄姑山路4号	浙江省杭州市黄姑山路4号
电话	0571-88212980	0571-88212980
传真	0571-88210763	0571-88210763
电子信箱	600460@silan.com.cn	600460@silan.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2025年，在持续的产品创新、人工智能数据中心、下一代高性能计算（HPC）应用、汽车电气化和智能化、人形机器人、新能源（包括风、光、储、充）等对半导体需求不断增长的带动下，全球半导体行业在2025年继续保持较快的增长态势。按世界半导体贸易组织（WSTS）发布的最新预测，2025年全球半导体市场规模达到7,920亿美元，较2024年增长25.6%，是自2021年（增幅为26.2%）以来最强劲的增长。

在国家积极“扩内需、促消费、稳增长”，大力发展新质生产力，加强科技自主创新，“强链延链补链”、加快数字中国建设、持续推进“人工智能+”行动、反“内卷”、实现高质量发展等一系列政策的推动下，国产芯片进口替代的进程明显加快。公司上下紧紧围绕董事会提出的“持续提升综合能力，发挥IDM模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；重点瞄准当前电动汽车、新能源、算力和通讯、人形机器人等产业快速发展的契机，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台”这一指导方针，继续在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品结构调整的步伐进一步加快。

2025年，公司营业总收入为1,305,157万元，比2024年增长16.32%；公司营业利润为15,473万元，比2024年增加利润25,546万元；公司利润总额为13,767万元，比2024年增加利润24,492万元；公司归属于母公司股东的净利润为39,855万元，比2024年增长81.27%；公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润37,206万元，比2024年增长47.82%。

公司三大类产品（集成电路、分立器件产品和发光二极管产品）营收情况、主要子公司、参股公司的经营情况：

1、集成电路营收情况

2025年，公司集成电路的营业收入为49.24亿元，较去年增长约20%，公司集成电路营业收入增加的主要原因是：公司IPM模块、MEMS传感器产品、32位MCU电路、快充电路、ASIC电路、车规级模拟电路等产品的出货量明显加快。

2025年，公司在汽车、大型白电、服务器、高端消费电子等领域，持续推出一批电源管理芯

片，应用于服务器的 DrMOS 电路、Efuse 电路、多项控制器电路，汽车上带功能安全的电源管理电路、汽车低压预驱电路、创新的高性能快充电路都已在客户端测试或已导入量产。公司已安排技改资金、加快 12 吋线车规级模拟电路工艺平台的建设；同时已经启动第二条 12 吋线的建设，一期规划投资 100 亿元人民币，建成后将形成年产 24 万片高端模拟集成电路芯片的产能。

2025 年，公司 32 位 MCU 电路产品继续保持较快的增长态势，其营业收入较去年同期增长约 55%。公司推出了基于 M0 内核的更大容量 Flash 更多管脚的通用高性能控制器产品，以满足智能家电、伺服变频、工业自动化、光伏逆变等多领域高性能控制的需求。经过多年持续发展与积累，公司电控类及主控类产品已形成系列化，与公司丰富的功率器件、IPM 模块一起为白电及工业客户提供一站式服务。创新的全士兰方案的变频空调（包含室内外 MCU、电源管理、IPM 模块、功率器件等）已在快速上量。

2025 年，公司 IPM 模块的营业收入达到 36.48 亿元，继续以较快的速度成长，较去年同期增长约 25%。目前，公司 IPM 模块已广泛应用到下游家电、工业和汽车客户的变频产品上，包括空调、冰箱、洗衣机，油烟机、吊扇、家用风扇、工业风扇、水泵、电梯门机、缝纫机、电动工具，工业变频器、新能源汽车等。公司各个功率等级的 IPM 模块已有近 10 年的整机应用质量统计数据，长期运行的失效率 PPM 统计处于非常好的水平，是国内外客户大量选用士兰产品的基础。2025 年，国内多家主流的白电整机厂商在变频空调等白电整机上使用了超过 2.5 亿颗士兰 IPM 模块，比去年同期增加约 47%。公司已提高 12 英寸模拟集成电路芯片和 IGBT 芯片生产能力。公司 6 英寸 SiC 功率器件芯片生产线正在持续上量，8 英寸 SiC 功率器件芯片生产线也已通线。公司 IPM 功率模块封装测试生产线的生产能力已提高到 4000 万只/月。预计今后士兰 IPM 模块的出货量还将保持 20-30%的较快增长。持续优化器件性能、提高功率密度、降低成本、高压 1200V 的 IPM 模块、SiC 器件和 GaN 器件的应用、拓展汽车用市场是士兰 IPM 模块今后发展的主要方向。

2025 年，公司 MEMS 传感器产品的营业收入达到 2.8 亿元，其较去年增加约 12%。目前，国内大多数手机品牌厂商已在大批量使用公司加速度传感器，公司加速度传感器的国内市场占有率保持在 20%-30%。公司六轴惯性传感器（IMU）已接获多家国内智能手机厂商批量订单，2025 年 IMU 出货量增加了约 1.8 倍。公司已在士兰集昕 8 吋线上持续加大 MEMS 传感器芯片制造能力的投入，预计 2026 年公司惯性传感器产品的营收将大幅增长。公司 MEMS 传感器产品除在智能手机、可穿戴设备等消费领域继续加大供应外，还在持续拓展工艺平台，研发更高精度的惯性传感器产品，产品将进入汽车、工业等市场。

2、功率半导体和分立器件产品营收情况

2025年，公司功率半导体和分立器件产品的营业收入达到63.79亿元，较去年增长约17%。其中，公司应用于汽车、光伏的IGBT和SiC（模块、器件）的营业收入达到32.73亿元，较去年增长约43%。

基于公司自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在国内外多家客户实现批量供货；公司用于汽车的IGBT器件（单管）也已实现大批量出货，公司用于光伏的IGBT器件（成品）、逆变控制模块、SiC MOS器件也实现批量出货。同时，公司应用于汽车主驱的IGBT和FRD芯片已在国内外多家模块封装厂批量销售，并在进一步拓展客户和持续放量过程中。2025年，公司8吋线、12吋线IGBT芯片产能已满载。

公司已完成V代IGBT和FRD芯片的技术升级，性能明显提升，应用于新一代的降本模块和高性能模块，已通过客户评测。公司还完成了多个电压平台的RC-IGBT（逆导型IGBT）产品的研发，该类产品性能指标先进，已开始在汽车主驱、储能、风电、IPM模块等领域中推广使用。

2025年，基于公司自主研发的II代SiC-MOSFET芯片生产的电动汽车主电机驱动模块出货量累计超过10万颗，客户端反映良好，客户数量已持续增加。公司第IV代SiC芯片与模块已通过客户评测，并已开始批量交付。

2025年，公司的II代SiC-MOSFET已通过国内顶级大厂的严苛认证，应用于AI算力中心电源上，实现大批量出货，同时配套销售的还有高性能中低压的MOSFET。

2025年，公司继续推进“士兰明镓6英寸SiC功率器件芯片生产线”项目的建设。截至目前，士兰明镓已形成月产10,000片6吋SiC-MOSFET芯片的生产能力。公司已经开发了多种规格的SiC芯片，可以满足汽车、新能源、工业、家电等多样性的需求。6吋SiC芯片出货量在四季度快速提升。

2025年，公司加快推进“士兰集宏8英寸SiC功率器件芯片生产线”项目的建设。四季度已实现8吋SiC大线通线，已形成月产5000片8吋SiC功率器件芯片的生产能力。

2025年，公司其他分立器件产品的营业收入约为31.06亿元，较去年下降约2%。其他分立器件产品包括超级结MOSFET、高性能中低压分离栅MOSFET、快恢复二极管、TVS/ESD保护器件、稳压管、开关管、肖特基二极管等。销售下降的主要原因是公司根据市场变化和各产线产能的安排，进行了产品结构的调整，减少了价值相对较低的芯片产出。在该等品类的产品中，超级结MOSFET、高性能中低压分离栅MOSFET技术性能持续在提升，产品性能达到业内领先的水平。已开始加快进入电动汽车、新能源、算力和通讯等市场，尤其中低压MOSFET在汽车领域成长较快。预期今后公司分立器件产品的营收将继续较快成长。

3、发光二极管产品营收情况

2025年，公司发光二极管产品的营业收入为7.65亿元，与去年基本持平。

2025年，公司子公司士兰明镓完成了LED芯片生产线资源的整合，前三季度产能利用率已提高到90%以上，但受四季度LED彩屏芯片市场竞争加剧、以及贵金属材料成本大幅上升的影响，士兰明镓适当减少了生产投入，其产能利用率有所降低。2026年，士兰明镓将进一步优化产品结构，持续推动植物照明、安防监控、mini显示屏芯片等上量，努力实现产能满载，并进一步加强成本控制，提高投入产出效率，积极争取减少经营性亏损。

2025年，因出口订单减少、国内市场竞争加剧，导致公司子公司美卡乐的营业收入较去年减少约30%；但从三季度开始，出口订单逐步恢复，且美卡乐通过提质降本，持续改善经营性现金流，降低负债水平。尽管2025年美卡乐出现了一定数额的亏损，但其生产经营活动总体保持稳定。2026年，美卡乐将进一步发挥倒装产品优势，积极扩大市场份额，力争实现盈利。

4、主要制造工厂经营情况

(1) 士兰集科

2025年，公司重要参股公司士兰集科公司产能处于满载水平，总计产出12吋芯片63.74万片，较去年增长约19%，实现营业收入31.87亿元，较去年增加约24%。2026年，随着功率器件和模拟电路芯片产能的进一步释放，士兰集科芯片产出能力还将进一步提升。

(2) 士兰集昕

2025年，公司子公司士兰集昕公司产能处于满载水平，总计产出8吋、12吋芯片81.95万片，较去年增加约10%，实现营业收入15.27亿元，较去年同期增加约7%，其经营性亏损较去年同期大幅度减少。2026年，士兰集昕将进一步扩充8英寸MEMS传感器芯片的制造能力，并优化功率器件芯片产能结构。

(3) 士兰集成

2025年，公司子公司士兰集成芯片生产线的产能处于满载水平，总计产出5、6吋芯片277.10万片，比去年同期增长约18%。士兰集成通过加快产品结构调整，加强成本控制，取得了较好的经济效益。

(4) 成都士兰

2025年，公司子公司成都士兰公司PIM模块封装生产线的产出均较去年同期有较快的增长，其营业收入较去年同期增长约30%。2026年，成都士兰公司将加快汽车半导体封装二期厂房建设，进一步扩大新型汽车级功率器件和功率模块的封装能力。

(5) 成都集佳

2025年，公司子公司成都集佳公司保持稳定生产，其营业收入较去年同期增长约40%，获利能力进一步提升。成都集佳公司已实施多个IPM模块封装扩产项目，已将年生产能力提高到约4.8亿颗。

(6) 士兰明镓

2025年，士兰明镓实现主营业务收入7.51亿元，较去年同期增加约20%。2026年，士兰明镓公司将继续加大在Mini显示、植物照明、安防监控、红外光耦、车用LED等中高端应用领域的拓展力度，进一步推出高附加值的产品，同时加快实现SiC功率器件芯片生产线产量爬升，改善盈利水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	26,768,101,138.87	24,796,971,085.75	7.95	23,907,585,687.76
归属于上市公司股东的净资产	11,968,643,469.69	12,214,785,178.19	-2.02	12,021,606,274.69
营业收入	13,051,573,759.84	11,220,869,038.95	16.32	9,339,537,962.75
利润总额	137,669,586.34	-107,246,331.88	不适用	-56,878,103.46
归属于上市公司股东的净利润	398,550,840.03	219,867,848.47	81.27	-35,785,761.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,058,845.76	251,700,319.34	47.82	58,899,236.58
经营活动产生的现金流量净额	1,497,727,444.41	442,537,726.10	238.44	316,832,150.73
加权平均净资产收益率(%)	3.29	1.81	增加1.48个百分点	-0.47
基本每股收益(元/股)	0.24	0.13	84.62	-0.02
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.13	84.62	-0.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,999,841,284.77	3,335,924,791.46	3,377,079,562.28	3,338,728,121.33
归属于上市公司股东的净利润	148,565,355.87	116,232,330.12	84,267,661.26	49,485,492.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,797,387.48	124,148,742.75	26,671,810.56	76,440,904.97
经营活动产生的现金流量净额	398,706,414.96	-66,323,024.89	866,226,633.06	299,117,421.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

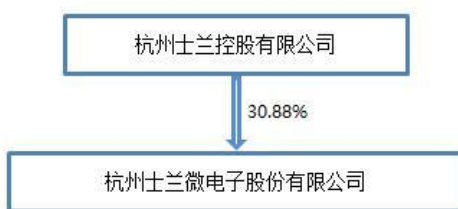
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					277,288		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					259,362		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州士兰控股有限 公司	0	513,917,034	30.88	0	无	0	境内 非国 有法 人

华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	61,975,000	3.72	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-9,634,774	30,722,637	1.85	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	25,022,539	1.5	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-656,902	19,319,164	1.16	0	无	0	其他
嘉兴晨壹恒旻股权投资合伙企业（有限合伙）	0	17,993,250	1.08	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	-6,707,200	14,842,473	0.89	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	-150,700	13,722,400	0.82	0	无	0	其他
陈向东	0	12,349,896	0.74	0	质押	6,587,000	境内自然人
范伟宏	0	10,613,866	0.64	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈向东、范伟宏为公司第一大股东杭州士兰控股有限公司之股东；其他前10名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动						

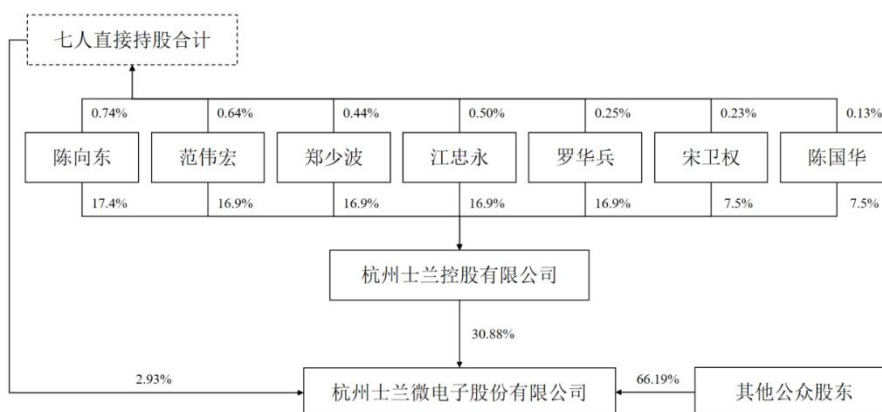
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年，公司营业总收入为 1,305,157 万元，比 2024 年增长 16.32%；公司营业利润为 15,473 万元，比 2024 年增加利润 25,546 万元；公司利润总额为 13,767 万元，比 2024 年增加利润 24,492 万元；公司归属于母公司股东的净利润为 39,855 万元，比 2024 年增长 81.27%；公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 37,206 万元，比 2024 年增长 47.82%。报告期内公司实现利润增长的主要原因：

1、报告期内，公司深入实施“一体化”战略。一方面，公司通过保持高强度的研发投入，持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、汽车、新能源、工业、算力和通讯等高门槛市场的拓展力度，公司总体营收保持了较快的增长势头。另一方面，公司通过积极扩大产出、采取各项降本增效举措，有效应对外部激烈市场竞争，使得公司产品综合毛利率与2024年相比保持了基本稳定。

2、报告期内，公司子公司士兰集成5、6吋芯片生产线、子公司士兰集昕8吋芯片生产线、重要参股企业士兰集科12吋芯片生产线均实现满负荷生产。士兰集成、士兰集昕、士兰集科三家公司的盈利水平较2024年有所提升。

3、报告期内，公司子公司成都士兰、成都集佳功率模块和功率器件封装生产线均保持稳定生产。成都士兰（含成都集佳）的盈利水平较2024年保持相对稳定。

4、报告期内，公司子公司士兰明镓经营性亏损较2024年有所增加，其亏损增加的主要原因：

（1）士兰明镓6吋SiC功率器件芯片生产线处于生产爬坡期，由于前期产出相对较少，生产成本中分摊的固定资产折旧金额较高，且前期采购的原材料主材成本较高，而SiC芯片市场价格下降幅度较大，导致SiC功率器件芯片生产线经营性亏损较大。公司已开发了多种规格的SiC功率器件芯片，可以满足汽车、新能源、工业、家电等多样性的需求。2025年下半年，士兰明镓SiC功率器件芯片生产线产出已经逐步增加，预计2026年将实现满产。

（2）士兰明镓LED芯片生产线产能利用率较2024年已有明显提升，产销量也有较大幅度的上升，并且随着植物照明、安防监控、Mini显示屏芯片上量，产品结构进一步优化，2025年全年经营性亏损较2024年有所减少。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

杭州士兰微电子股份有限公司

董事长：陈向东

2026年4月23日